

RECOMMENDED SOLDER LANDS
EMPFOHLENE LÖTFLÄCHE



C3
C2
C1

C7
C6
C5

27,4

1,7

1,3

4°... 180°
CARD INPUT AREA
KARTENEINFÜHRUNGSBEREICH

SIM CARD
ACCORDING
TO GSM 11.11
SIM KARTE

2,5±0,1

SUPPORTING SURFACE FOR COPLANARITY
AUFLAGEFLÄCHE FÜR KOPLANARITÄT

14,8

11,8

5,5

1,9

5,5

COVER LOCKED
DECKEL GESCHLOSSEN

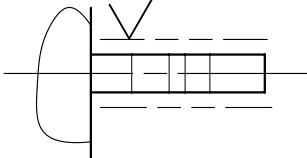
COVER UNLOCKED
DECKEL OFFEN

NO TRACKS ON THE PCB IN THIS AREA ALLOWED
KEINE LEITERBAHNEN AUF DER PLATINE IN DIESEM BEREICH ZULÄSSIG

** MAX. DIMENSION ONLY
DURING LOCKING OPERATION
** MAX. MAß NUR WÄHREND
DEM SCHLIEßEN

DETAIL A 10:1
ANSICHT A 10:1

TIN PLATED VERZINNT



SPRUE INCREASED
MAX. 0,6 mm
ANGUß MAX
0,6 mm ERHABEN

OPTIONAL HOLES FOR PRODUCTION LINE
OPTIONAL LÖCHER FÜR PRODUKTIONSLINIE

SPRUE RECESSED
ALLOWED
ANGUß VERTIEFT
ZULÄSSIG

AMPHENOL
SIMLOCK®

OPEN
OPEN

PICK & PLACE AREA (ø3,0)
BEREICH FÜR PICK & PLACE (ø3,0)

COVER LOCKED
DECKEL GESCHLOSSEN

MAX. 17,3 **

7,55

2,54

0,5±0,05

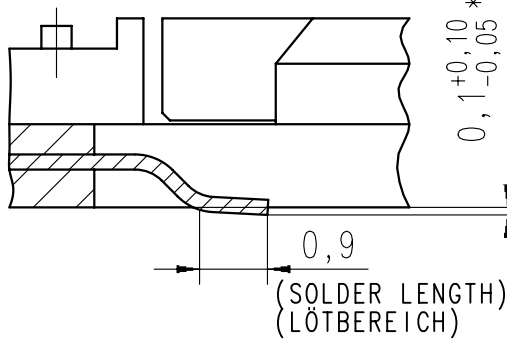
5,08

3,65±0,05

13,3

0,2

SIDE VIEW 10:1
SOLDER PIN
SEITENANSICHT 10:1
LÖTPIN



* DEVIATIONS BETWEEN ALL
CONTACTS MAX. 0,08 mm
EACH SIDE
* ABWEICHUNGEN ZWISCHEN
ALLEN KONTAKTEN MAX. 0,08 mm
PRO SEITE